**Samtec stellt Analog-over-ArrayTM-Referenzdesigns vor**

**Neue Referenzdesigns ermöglichen die Übertragung von Hochgeschwindigkeits-Digital-, Analog- und Stromversorgungssignalen über einen einzigen Array-Steckverbinder.**

[**New Albany, Indiana, USA**]--Samtec, Inc., der Führende Anbieter für Steckverbinder, hat seine Open-Pin-Field-Arrays um die Möglichkeit erweitert, gleichzeitig analoge, digitale und Stromsignale zu verarbeiten. Neue Referenzdesigns ermöglichen jetzt auch die Unterstützung von analogen Signalen durch die bewährten Hochleistungs-Steckverbinder-Arrays von Samtec, wie beispielsweise dem [SEARAY](https://www.samtec.com/connectors/high-speed-board-to-board/high-density-arrays/searay)TM.

Die neuen Analog-over-Array-Referenzdesigns sind für den Einsatz in High-Density-HF-Anwendungen vorgesehen und ermöglichen dichte Steckverbinder mit offenem Pin-Feld, die digitale und analoge Differenzial- oder Single-Ended-Signalübertragung sowie Stromversorgungen unterstützen. Diese hochdichten Array-Steckverbinder haben sich bereits in Hochgeschwindigkeits-, Hochleistungs-Digital- und Stromversorgungsanwendungen bewährt. Jetzt kann ihr differentielles Erdungsmuster auch zur für HF-SOCs und Anwendungen wie 5G Wireless, Remote PHY/MSOs, Phased-Array-Radar, Test und Messung sowie LEO/MEO-Satelliten eingesetzt werden.

Performance is specified at

• 8 GHz Bandbreite

• 50 Ohm Systemimpedanz für Single-Ended; 100 Ohm für Differentiell

• Rückflussdämpfung von -12 dB bis zu 4 GHz; -10 dB bis zu 8 GHz;

• Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen: -69 dBc bis 4 GHz, -63 dBc bis 8 GHz

Das [reference design](https://suddendocs.samtec.com/testreports/20230809_t-3585732_aoac_seam-035_seaf-065_10mm_rev3.pdf) eine empfohlene Pinbelegung als Teil eines vollständigen Spezifikationsberichts. Weitere Referenzdesigns für Anwendungen bis zu 40 GHz sind in der Entwicklung. Weitere Informationen über die Auswahl von PCB-Materialien, Stapelung und Startoptimierung für Ihr Design erhalten Sie per E-Mail unter [sig@samtec.com](mailto:sig@samtec.com).

Das 1976 gegründete Unternehmen Samtec ist ein privater, weltweit tätiger Hersteller mit einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar, der eine breite Palette elektronischer Verbindungslösungen anbietet, darunter High-Speed Board-to-Board, High-Speed-Kabel, Mid-Board- und Panel-Optik, Präzisions-HF, Flexible Stacking und Micro/Rugged-Komponenten und Kabel.  Die Technologiezentren von Samtec befassen sich mit der Entwicklung und Weiterentwicklung von Technologien, Strategien und Produkten, um sowohl die Leistung als auch die Kosten eines Systems vom nackten Chip bis zu einer 100 Meter entfernten Schnittstelle und allen dazwischen liegenden Verbindungspunkten zu optimieren.

A close-up of several electronic components

Description automatically generated